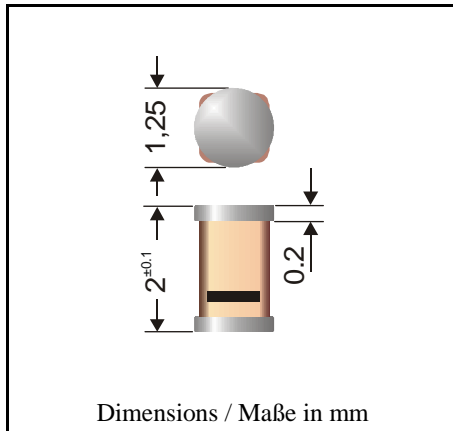


Surface mount Schottky-Barrier Diodes Schottky-Barrier Dioden für die Oberflächenmontage

Version 2004-02-03



Power dissipation Verlustleistung	400 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20 ... 40 V
Glass case Glasgehäuse	Quadro-MicroMELF
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

Maximum ratings ($T_A = 25/^\circ\text{C}$)**Grenzwerte ($T_A = 25/^\circ\text{C}$)**

		MCL103A	MCL103B	MCL103C
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	40 V	30 V	20 V
Power dissipation – Verlustleistung	P_{tot}	400 mW ¹⁾		
Max. average forward current (dc) Dauergrenzstrom	I_{FAV}	200 mA ¹⁾		
Peak fwd. surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen	I_{FSM}	15 A		
Junction temperature – Sperrschichttemp.	T_j	125/°C		
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	- 55...+ 175/°C		

Characteristics ($T_j = 25/^\circ\text{C}$)**Kennwerte ($T_j = 25/^\circ\text{C}$)**

		Min.	Typ.	Max.
Forward voltage – Durchlaßspannung ²⁾				
$I_F = 20 \text{ mA}$	V_F	–	–	0.37 V
$I_F = 200 \text{ mA}$	V_F	–	–	0.6 V
Leakage current – Sperrstrom ²⁾				
$V_R = 10 \text{ V}$	MCL103C	I_R	–	5 : A
$V_R = 20 \text{ V}$	MCL103B	I_R	–	5 : A
$V_R = 30 \text{ V}$	MCL103A	I_R	–	5 : A

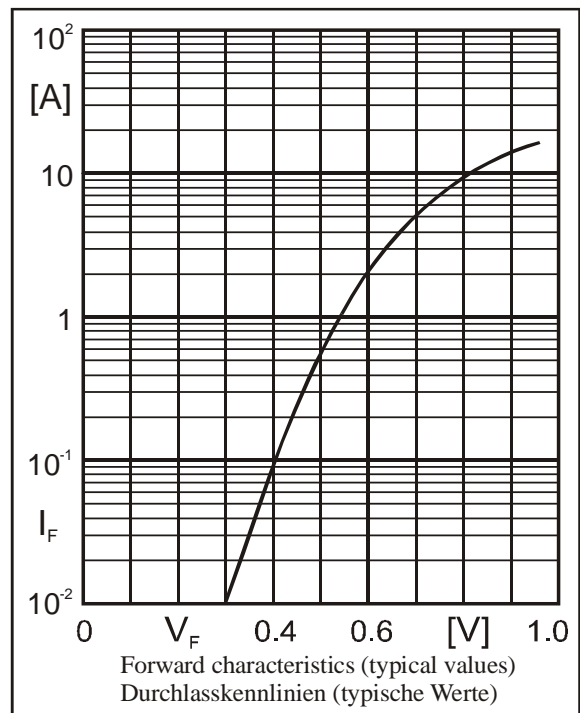
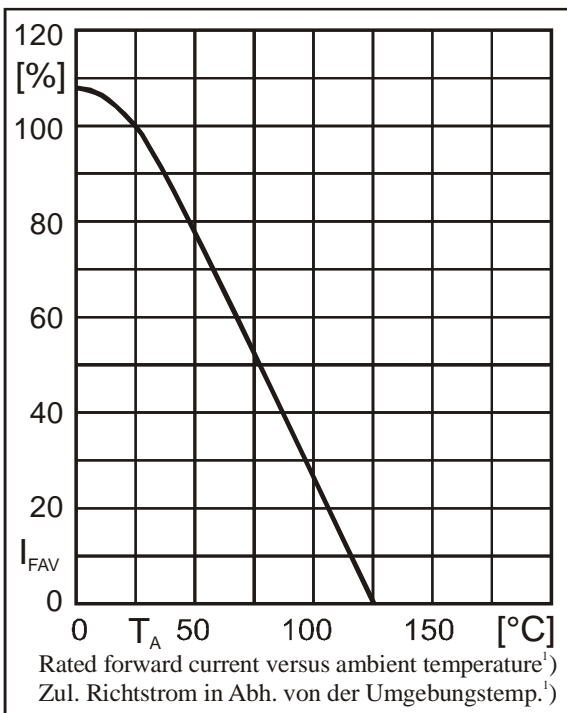
¹⁾ Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal

Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß

²⁾ Tested with pulses $t_p = 300 \text{ } \mu\text{s}$, duty cycle # 2% – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300 \text{ } \mu\text{s}$, Schaltverhältnis # 2%

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

	Min.	Typ.	Max.
Junction capacitance – Sperrschichtkapazität $V_R = 0, V_f = 1 \text{ MHz}$	–	50 pF	–
Reverse recovery time – Sperrverzug $I_F = 200 \text{ mA}$ through/über $I_R = 200 \text{ A}$ to/auf $I_R = 20 \text{ mA}$	–	10 ns	–
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R_{thA}		300 K/W ¹⁾



¹⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß